

1-8-4 その他（短絡）／其它（短路）／Others(electrical short)

1-8-4-1 導電性異物圧着短絡／压入导电性杂物的短路／Short by an adhered conductive foreign object

【特徴】 導電性異物が複数の回路線に跨って圧着されている状態の短絡

【特征】 导电性杂质横跨多条线路并被压入的短路。

【Characteristics】 A conductive foreign object bridge several conductors and adhered to the board by pressure

【原因・判断ポイント・発生工程】 銅屑等の導電性異物が、打抜プレス工程や基板の積み重ね等で複数の回路線に跨って圧着されて出来たもの（打抜プレス工程、回路形成後のマテハン）

【原因、判断要点、発生工序】 在冲切工序或者板件堆垛作业等压入铜屑等的导电性杂质，横跨多条线路而引起的（冲切工序、图形转移后的搬运）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A conductive foreign object such as copper debris is adhered by pressure crossing across multiple conductors in punching board or stacking boards, causing the defect. (Blanking process - material handling after forming conductor pattern)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

1-8-4-2 導電性異物 SR 巻込短絡／SR 中卷入导电性杂物的短路／Short by a conductive foreign object within solder resist

【特徴】 SR中に巻込まれた導電性異物を介した短絡

【特征】 SR 中卷入导电性杂物的短路。

【Characteristics】 Short caused by a conductive foreign object entrapped in solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布時に巻込まれた導電性異物が回路導体間に跨ったことにより出来たもの（ソルダレジスト塗布工程）



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×